



Electronics for the Future

決算説明会 2024年度 通期業績

2025年5月14日

ローム株式会社

代表取締役社長 東 克己

- | 2024年度通期 業績報告
- | 2025年度通期 発表計画
- | 設備投資の状況
- | 在庫の状況
- | 株主還元
- | キャッシュフロー・資金政策について
- | 中期経営計画の進捗・振り返り
- | 収益性改善の施策
- | ロームのマーケティング戦略
- | SiC事業の戦略

2024年度 通期 実績 (修正計画比、前年比)

(単位：億円)

	FY2024 実績	FY2024 修正計画	計画比	FY2023 実績	前年比
売上高	4,484	4,500	▲0.3%	4,677	▲4.1%
営業利益	▲400	▲150	-	433	-
(対売上比率)	(▲8.9%)	(▲3.3%)	-	(9.3%)	-
経常利益	▲296	▲100	-	692	-
(対売上比率)	(▲6.6%)	(▲2.2%)	-	(14.8%)	-
純利益	▲500	▲60	-	539	-
(対売上比率)	(▲11.2%)	(▲1.3%)	-	(11.5%)	-
EBITDA	433	742	▲41.4%	1,153	▲62.3%
(対売上比率)	(9.7%)	(16.5%)	-	(24.7%)	-

期中平均レート(¥/US\$) (152.48円)

(148.93円)

(144.40円)

期末レート(¥/US\$) (149.52円)

(145.00円)

(151.41円)

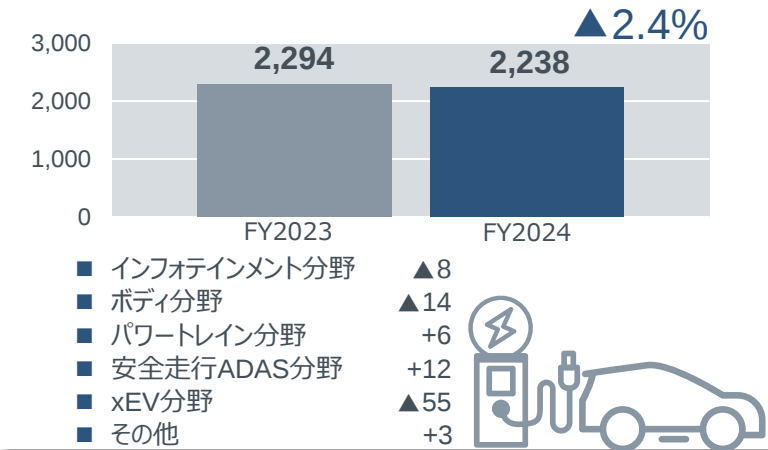
2024年度 通期 市場別 売上の変動要因（前年比）

（単位：億円）

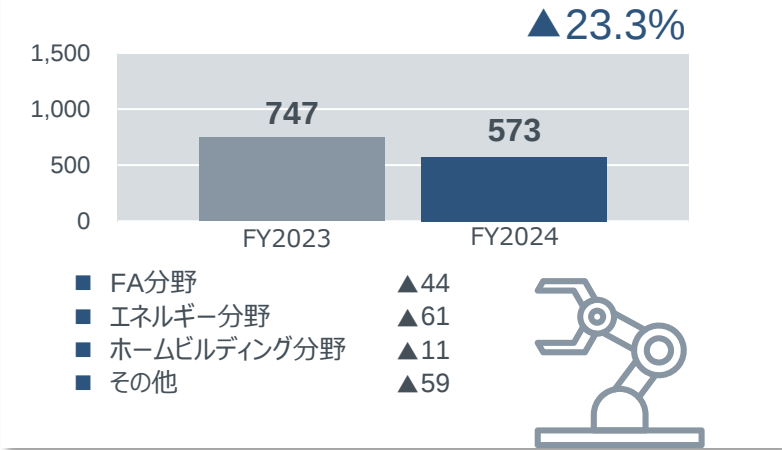
通期売上高



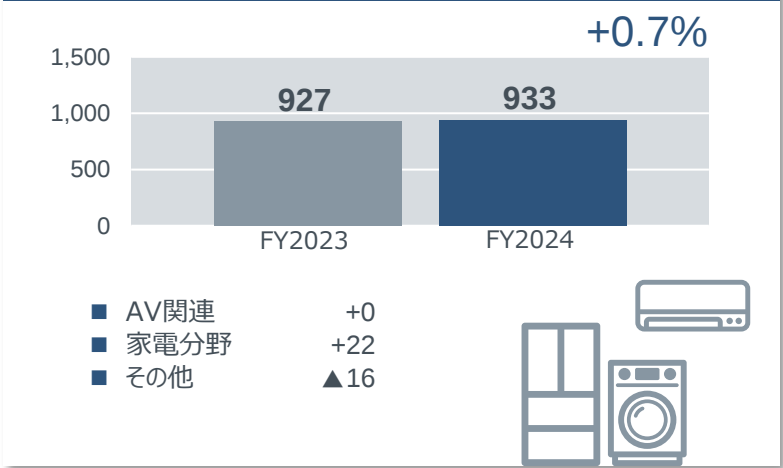
自動車



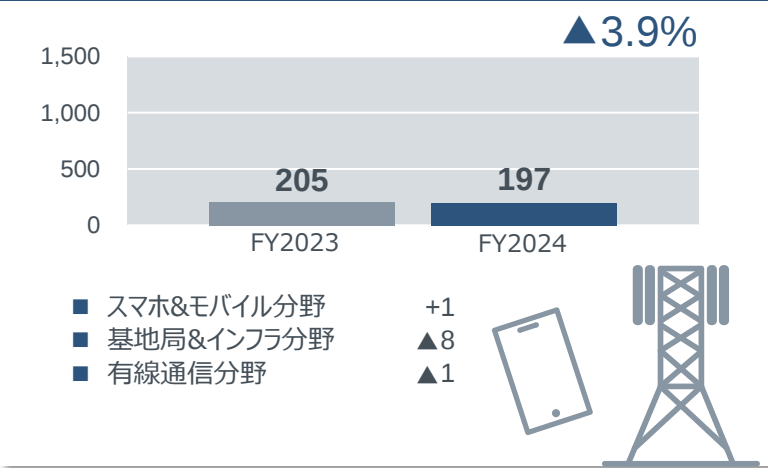
産機



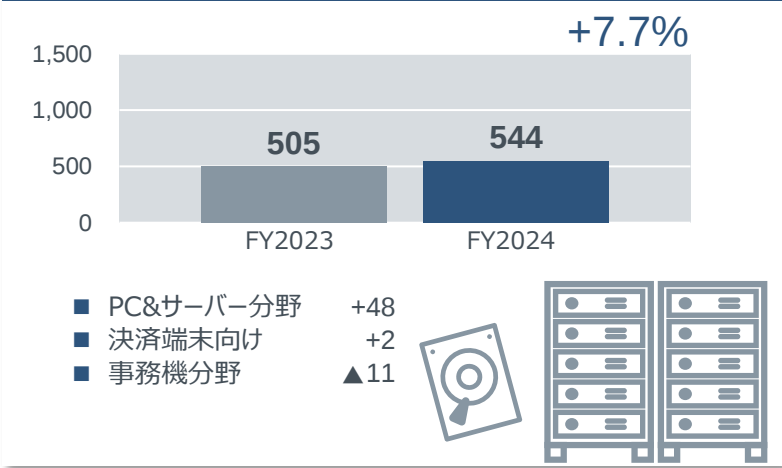
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 通期 国籍別 売上の変動要因 (前年比)

通期売上高

4,677億円

FY2023 通期実績

4,484億円

FY2024 通期実績

▲4.1%

海外売上高比率

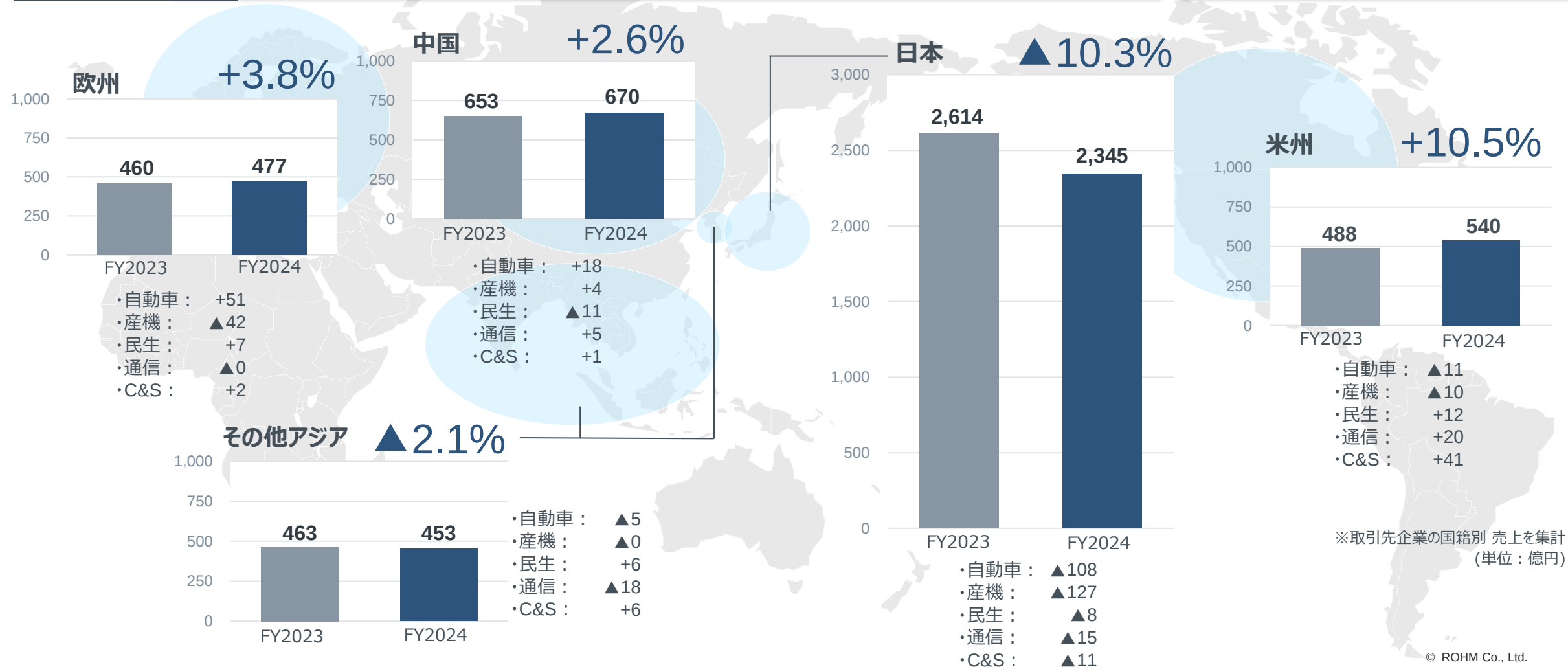
44.1%

FY2023 通期

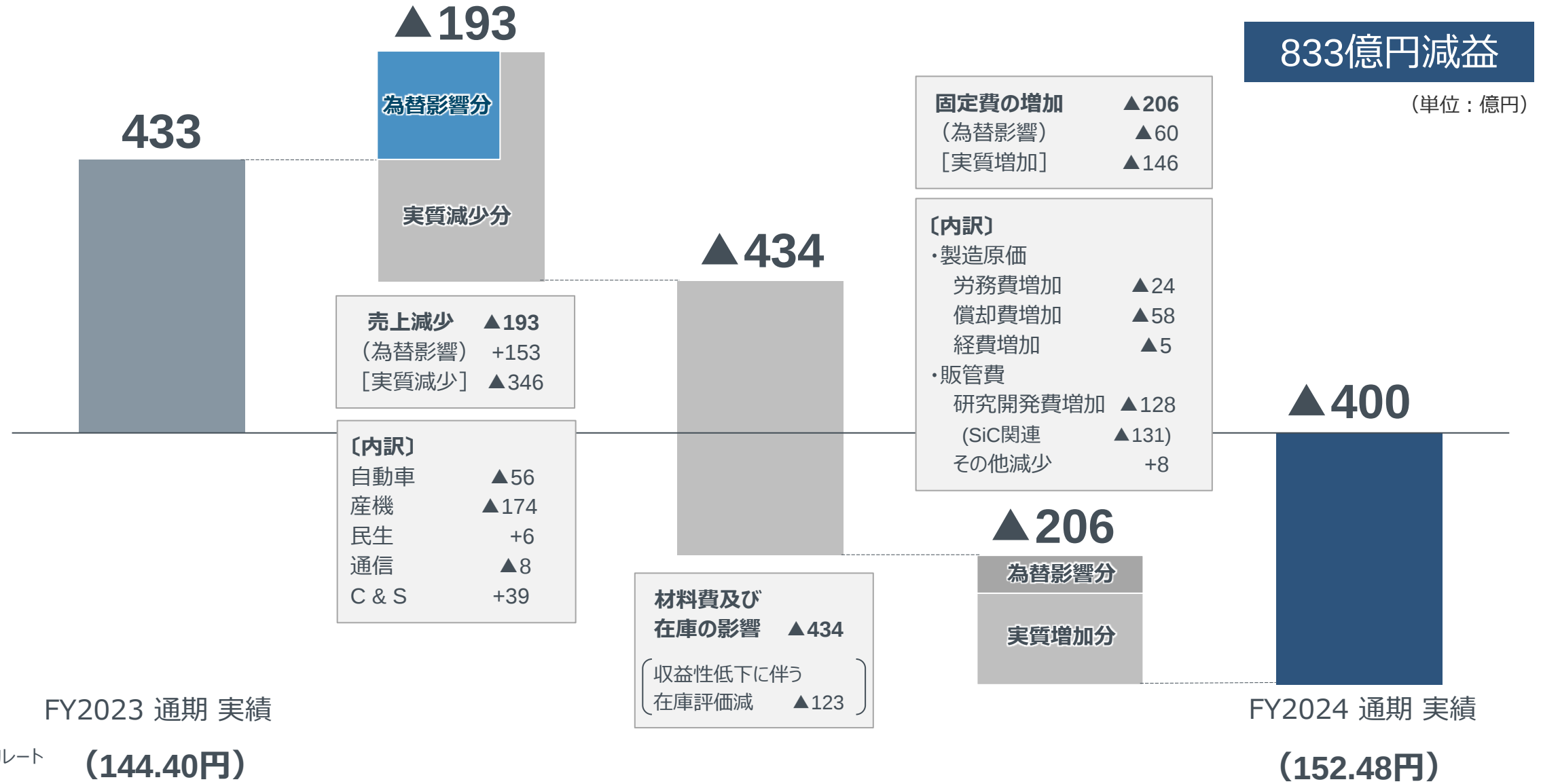
47.7%

FY2024 通期

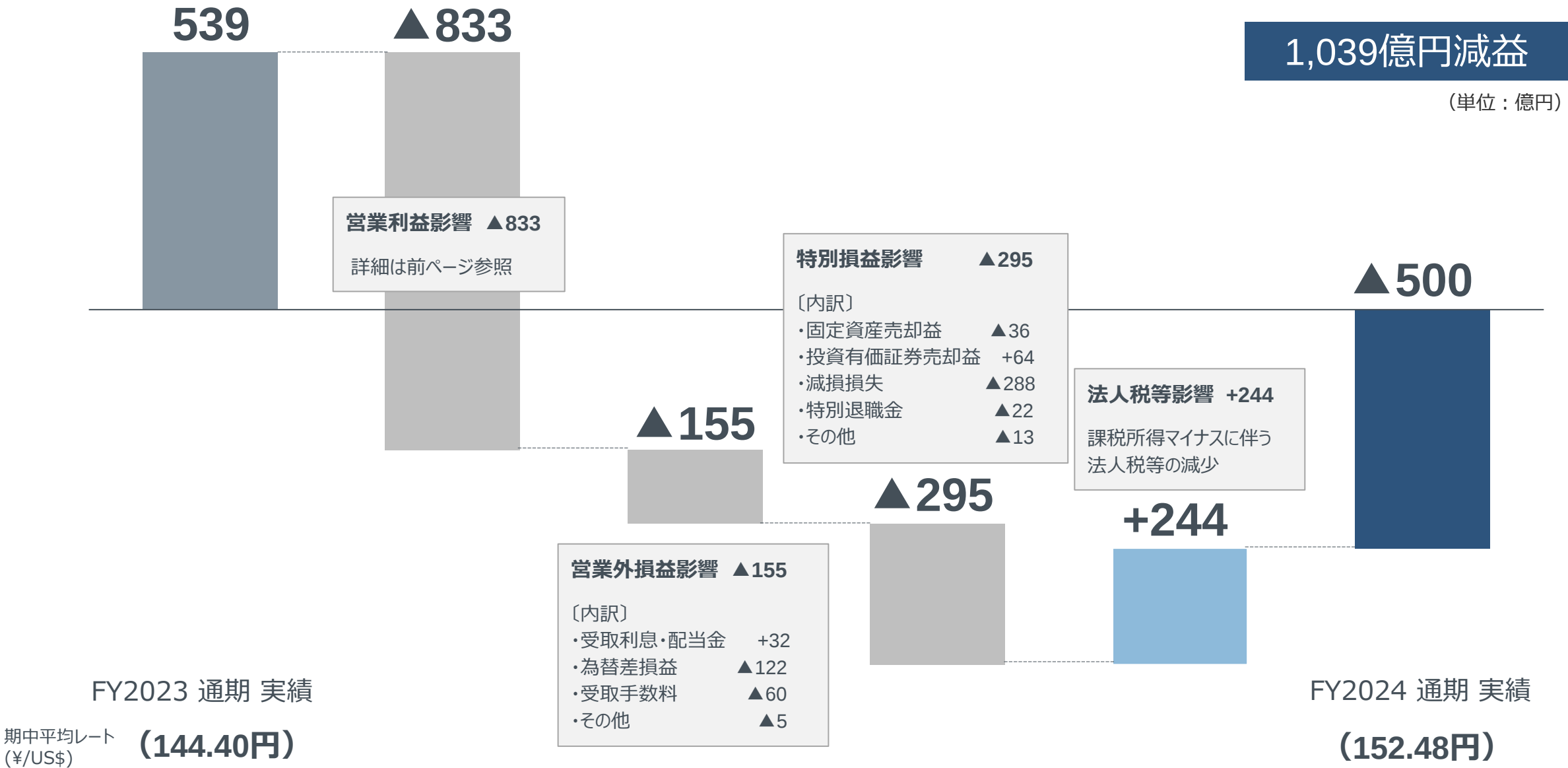
通期実績 前年比



2024年度 通期 営業利益 増減分析（前年比）



2024年度 通期 当期純利益 増減分析（前年比）



2024年度 通期 実績 セグメント別 (前年比)

(単位：億円)

		FY2024 実績	FY2023 実績	増減額	増減率
LSI	売上	2,038	2,072	▲34	▲1.6%
	セグメント利益	▲7	212	▲219	-
	(利益率)	(▲0.4%)	(10.3%)	-	-
半導体素子	売上	1,870	2,019	▲149	▲7.4%
	セグメント利益	▲458	129	▲587	-
	(利益率)	(▲24.5%)	(6.4%)	-	-
モジュール	売上	325	329	▲4	▲1.1%
	セグメント利益	26	20	+6	+34.2%
	(利益率)	(8.3%)	(6.1%)	-	-
その他	売上	250	257	▲7	▲2.6%
	セグメント利益	25	21	+4	+17.1%
	(利益率)	(10.1%)	(8.4%)	-	-

2025年度 通期 計画 (前年比)

(単位：億円)

	FY2025 計画	FY2024 実績	増減額	増減率
売上高	4,400	4,484	▲ 84	▲ 1.9%
営業利益	40	▲ 400	+440	-
(対売上比率)	(0.9%)	(▲ 8.9%)	-	-
経常利益	110	▲ 296	+406	-
(対売上比率)	(2.5%)	(▲ 6.6%)	-	-
純利益	70	▲ 500	+570	-
(対売上比率)	(1.6%)	(▲ 11.2%)	-	-
EBITDA	656	433	+223	+51.3%
(対売上比率)	(14.9%)	(9.7%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (140.73円) (152.48円)

期末レート(¥/US\$) (140.00円) (149.52円)

2025年度 ローム売上見通しサマリ



【YoY】
前年比

+10%~

+10%~+2%

+2%~▲2%

▲2%~▲10%

▲10%~

市場	2025年度の見通し	1H	2H
自動車 (▲4.8%)	■ 欧州向けを中心に、xEV分野でSiCデバイスの売上が伸長。 ■ 需要低迷にともなう生産調整が継続、2025年度での回復は不透明。	 ▲8.4%	 ▲1.0%
産機 (▲2.6%)	■ 一部顧客で在庫調整が長期化しており、上期は調整が続く。 下期以降徐々に改善に向かう見込み。	 ▲9.2%	 +4.5%
民生 (+11.2%)	■ アミューズメント向けで大きく売上増加。 ■ 家電向けは、足元でエアコン向けで駆け込み需要があるも、年間通じて調整局面が続く。	 +12.8%	 +9.4%
通信 (▲18.5%)	■ スマホ向けが年間通じて低調。	 ▲23.8%	 ▲11.6%
コンピュータ& ストレージ (▲5.5%)	■ サーバー向けは売上成長を見込むも、全体として低調に推移。 ■ SSD/HDD向けは下期から回復見込み。	 ▲7.9%	 ▲2.8%

2025年度 通期計画 市場別 売上の変動要因（前期比）

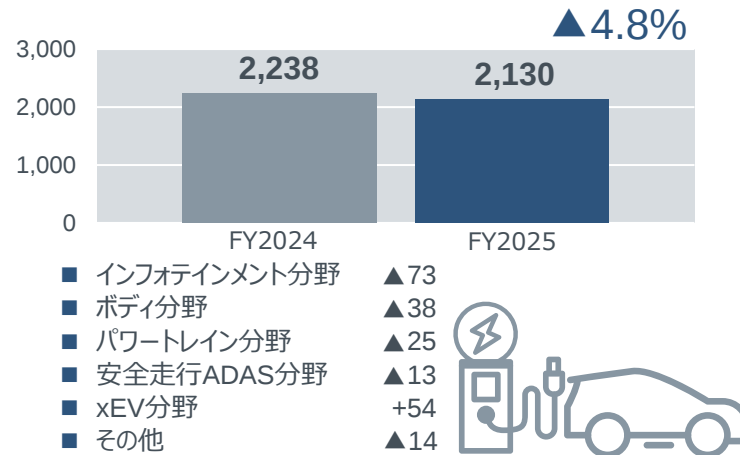
（単位：億円）

通期売上高

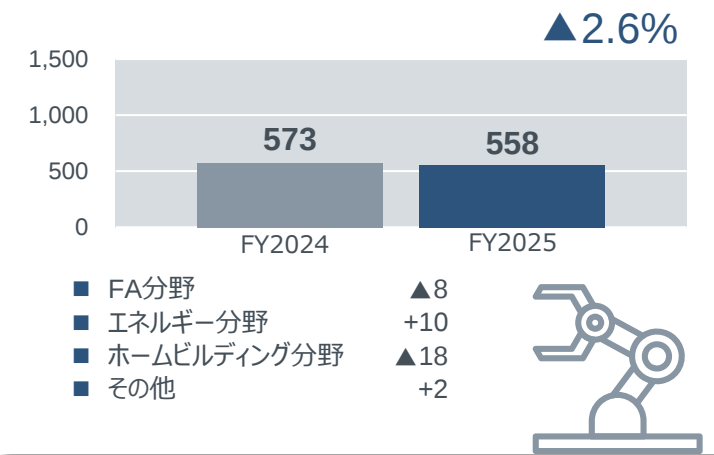
4,484億円

FY2024 通期
実績▲1.9%
4,400億円FY2025 通期
計画

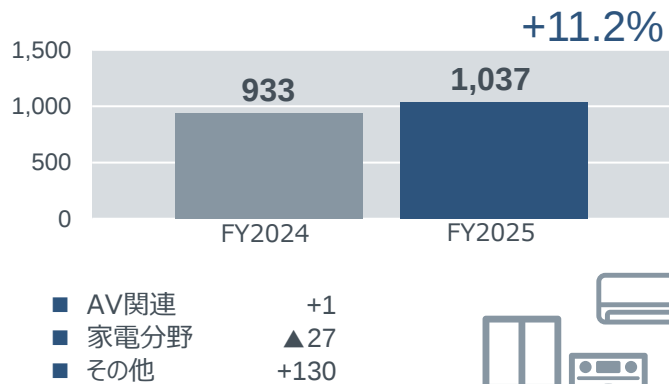
自動車



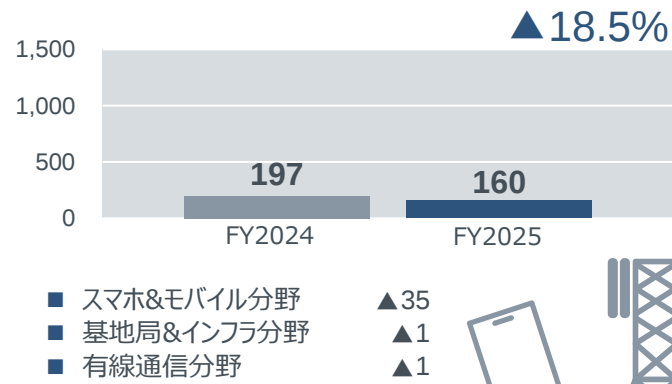
産機



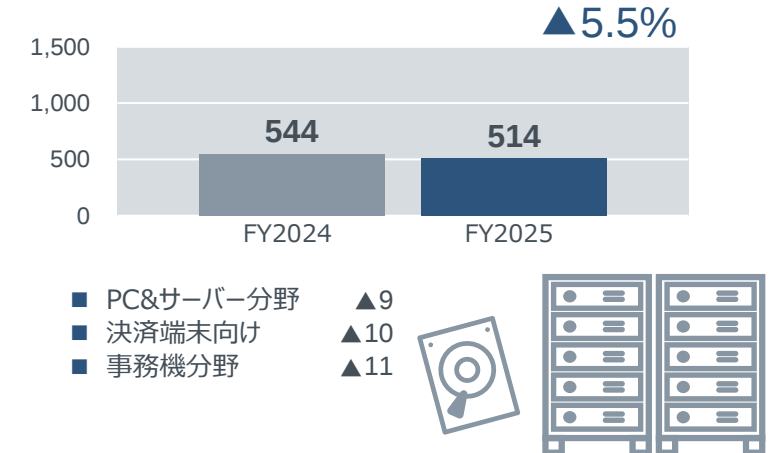
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2025年度 通期計画 国籍別 売上の変動要因（前期比）

通期売上高

4,484億円

FY2024 通期実績

4,400億円

FY2025 通期計画

▲1.9%

海外売上高比率

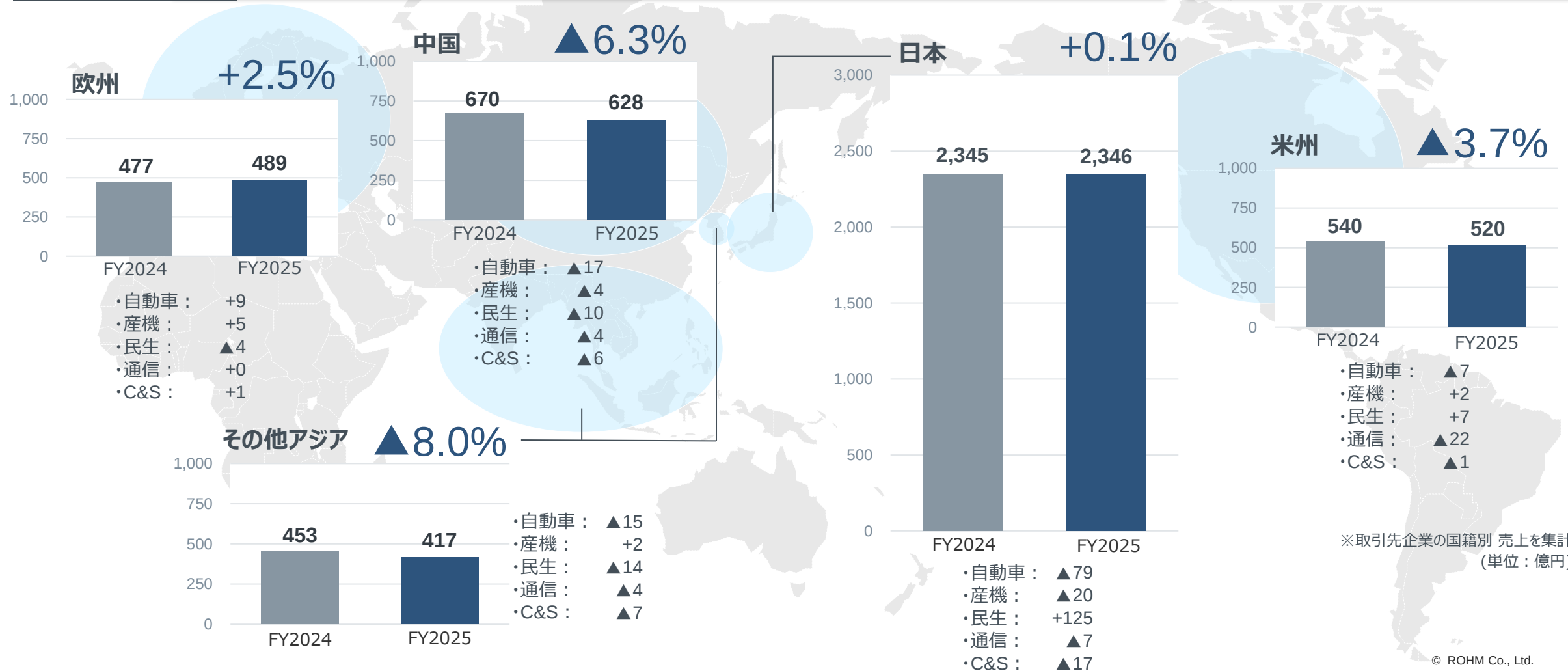
47.7%

FY2024 通期

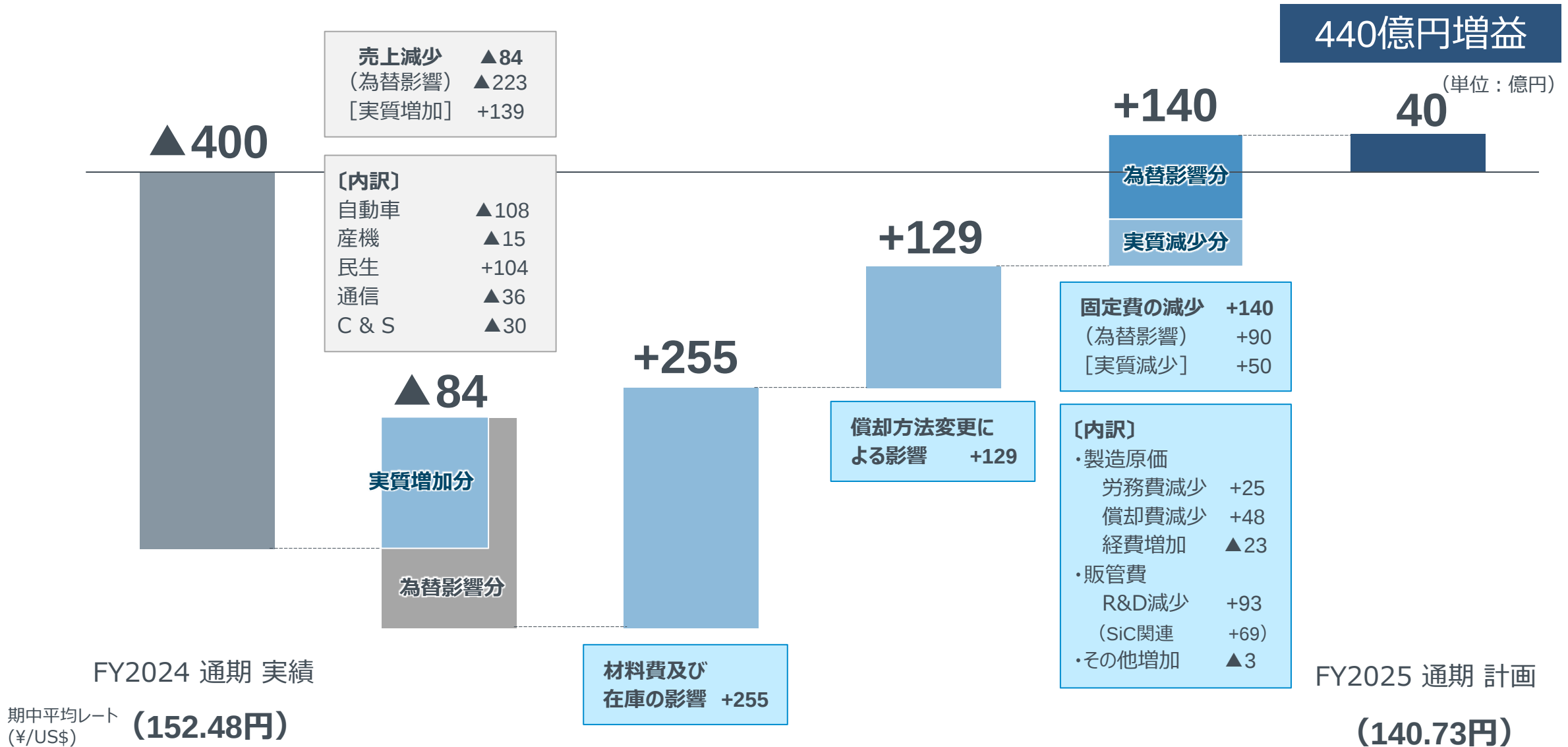
46.7%

FY2025 通期

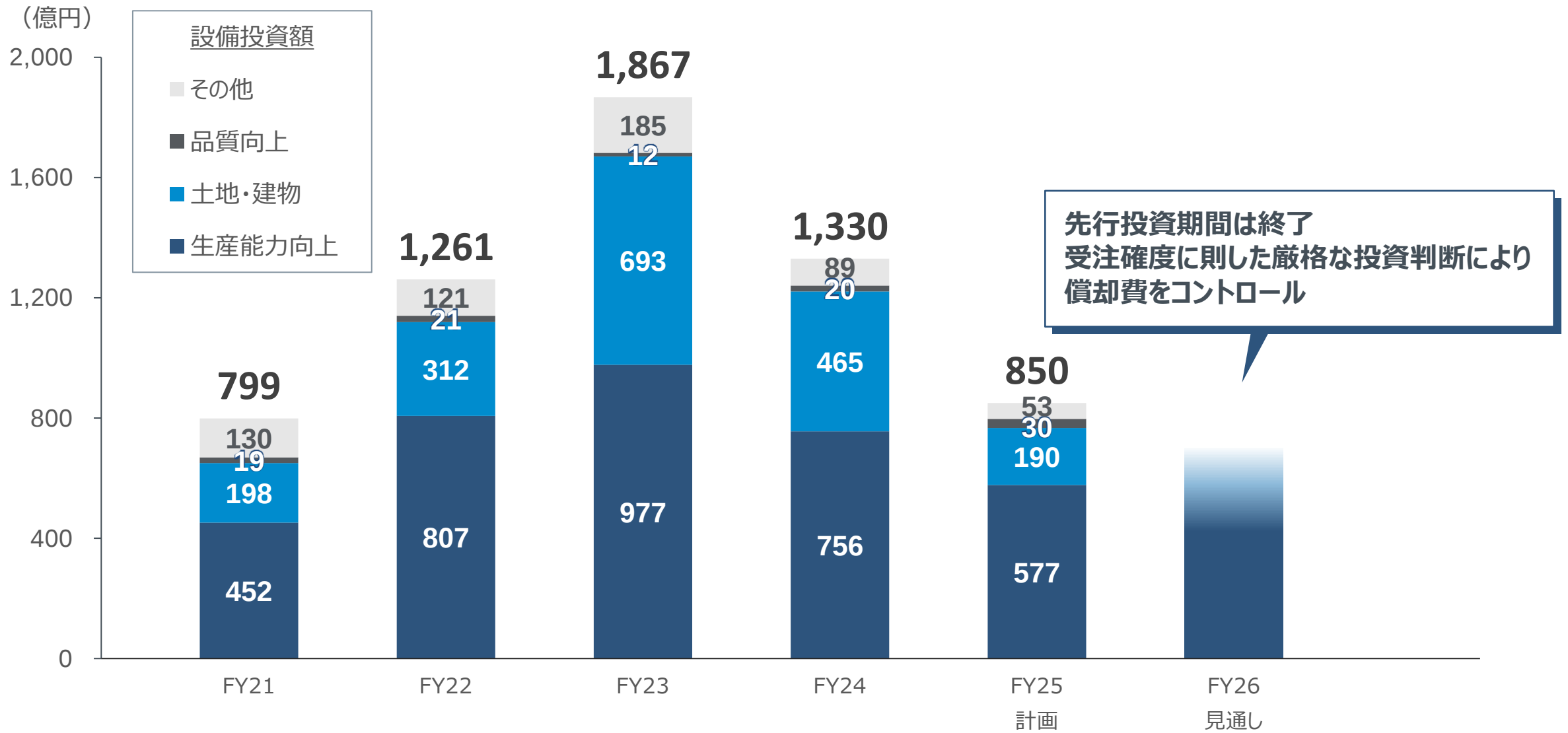
通期計画 前期比



2025年度 通期計画 営業利益 増減分析 (前期比)



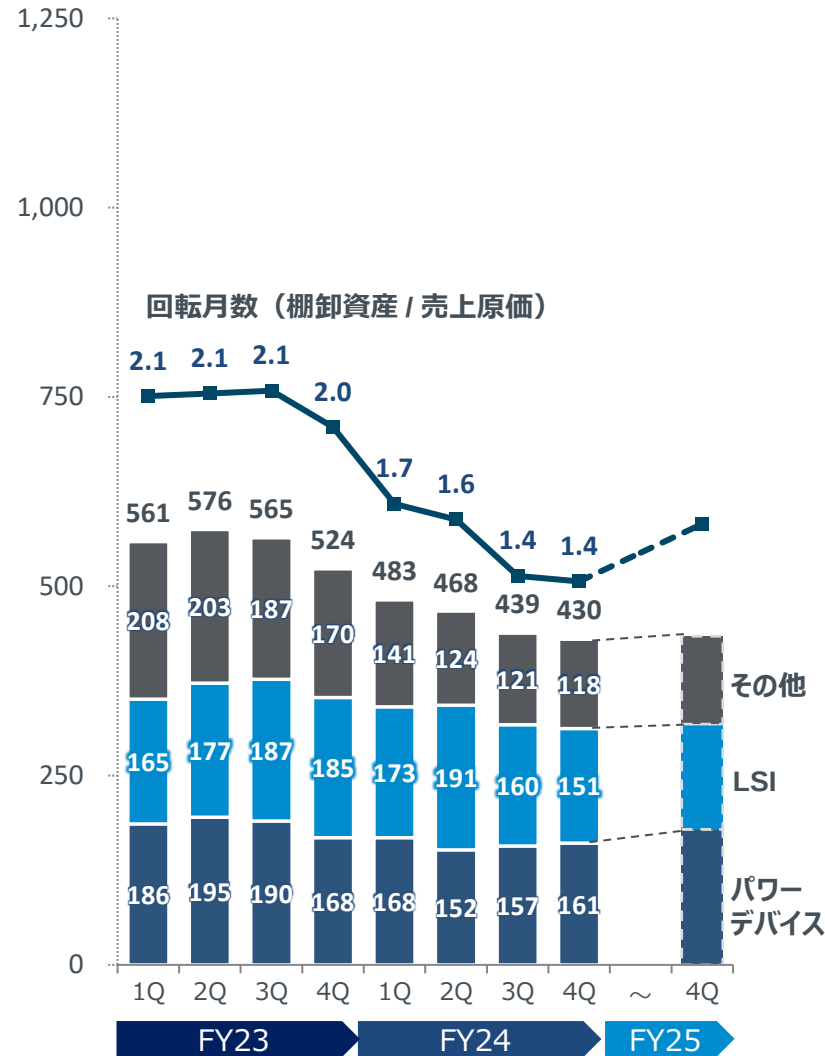
設備投資の状況



在庫の状況（金額）

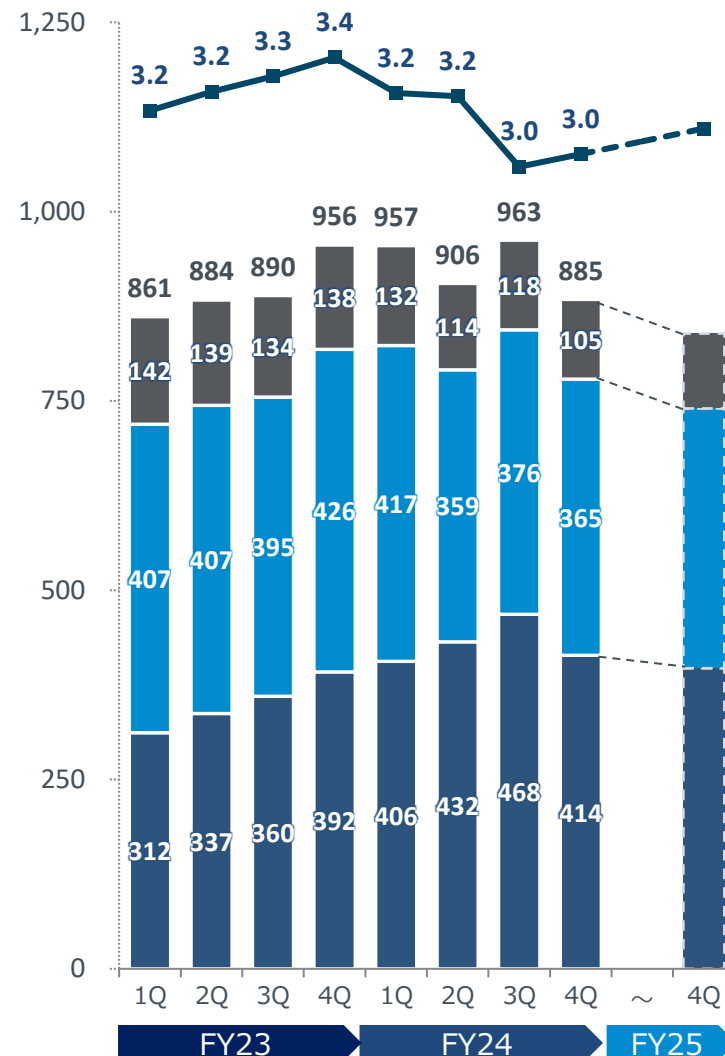
商品及び製品

(億円)



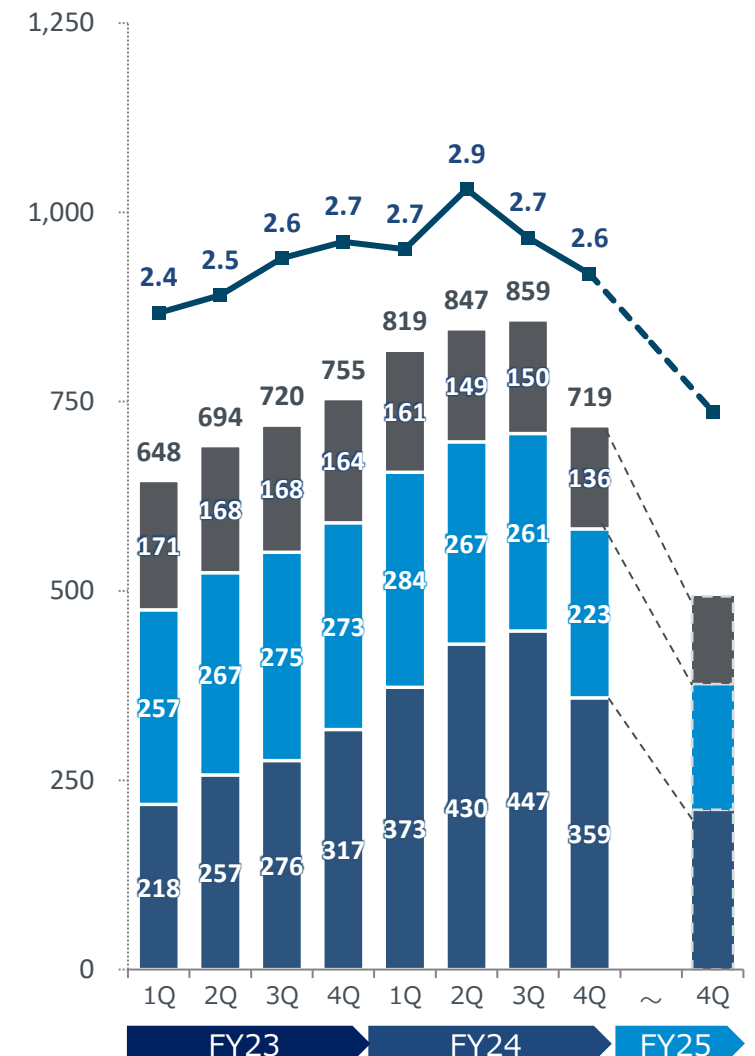
仕掛品

(億円)

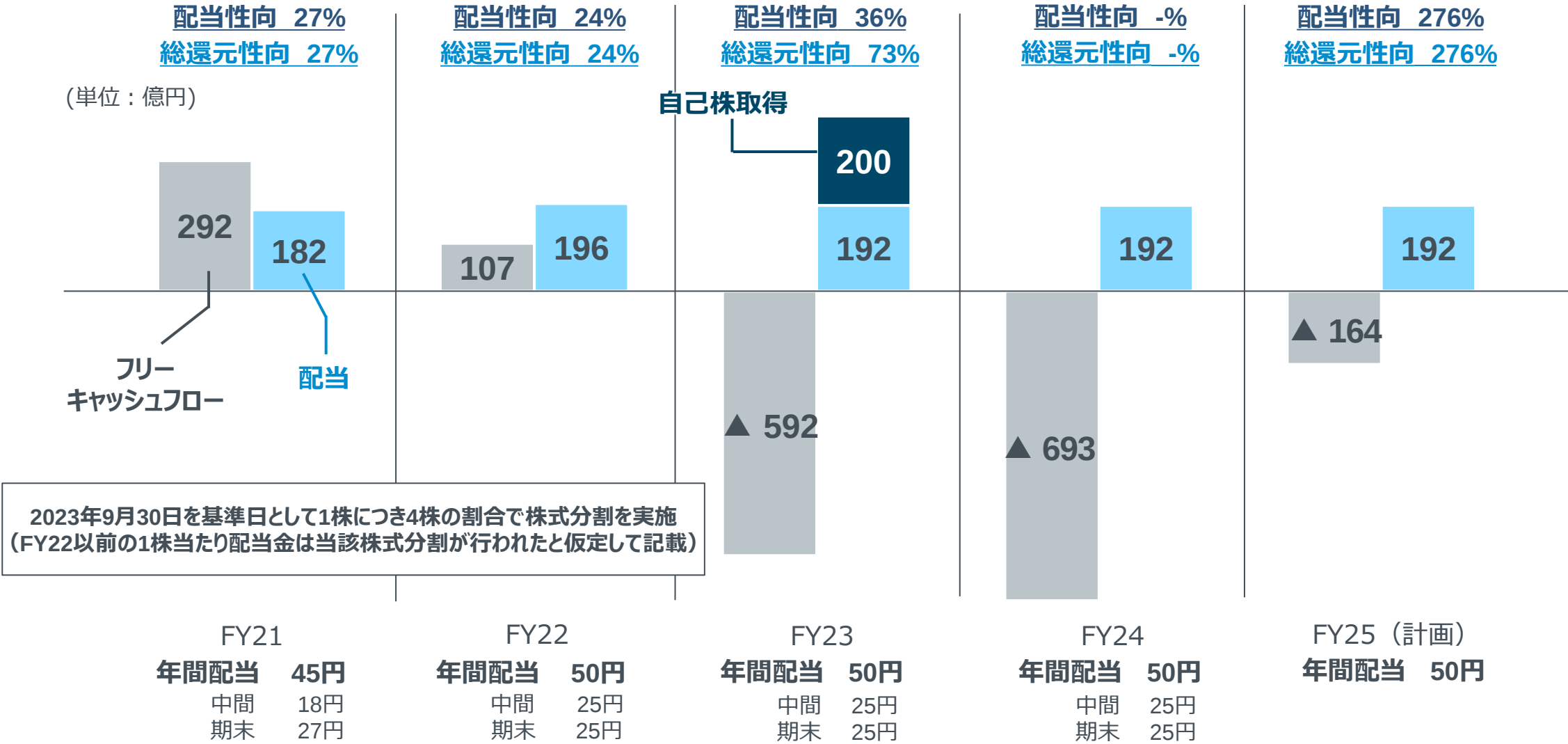


原材料及び貯蔵品

(億円)



株主還元の推移



*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 + 減損損失 - 設備投資

財務戦略（FY21～FY25）

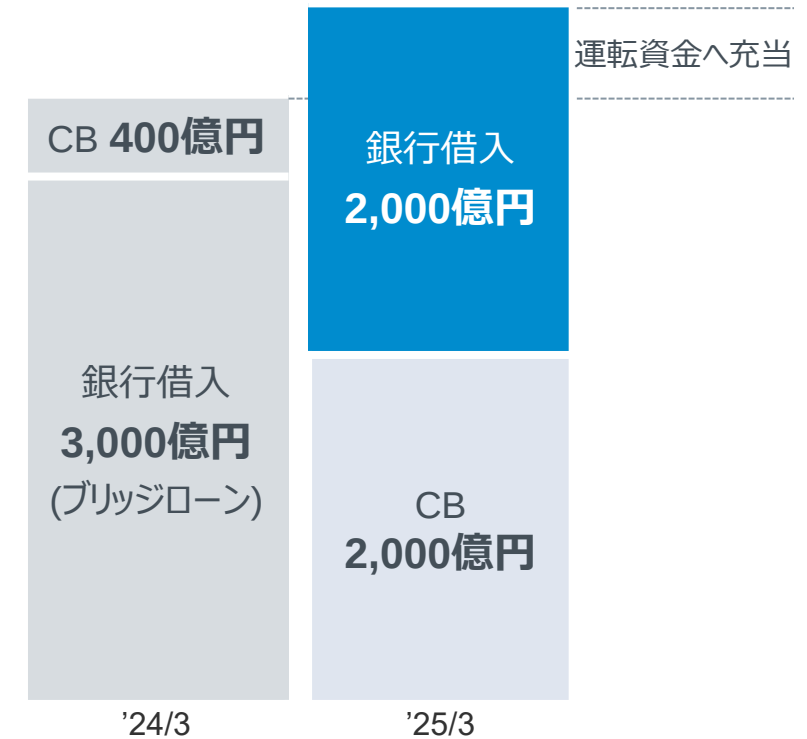
- 成長投資7,000億円→6,100億円へ抑制
- 東芝への出資で活用したブリッジローンの残債返済と'24/12満期CBの現金償還は銀行借り入れで実施済
- FCFはFY25は改善に向かい、FY26はプラスへ。D/Eレシオ<0.5、手元資金2,000億円を財務規律の目安とし健全性を担保
- 株主還元方針は変更なし

キャッシュアロケーション（FY21～FY25 5年累計）



- ### 株主還元
- 連結配当性向30%を目安に還元
 - 資本効率の改善を目的に自己株式取得を適時実施
- ### 成長投資
- SiCパワーデバイス 8inch生産能力の増強
 - ・ ローム・アポロ筑後工場 新棟
 - ・ ラピス宮崎第2工場（拠点新設）
 - LSI 12inch Bi-CDMOS生産ライン増強

資金調達の実績



※FY20 期末時点

中期経営計画の進捗・振り返り

財務目標

	中期目標	FY25計画
売上高	6,000億円以上	4,400億円
営業利益率	20%以上	0.9%
ROE	9%以上	0.8%
海外売上比率	50%以上	46.7%

非財務目標

	中期目標	FY24実績
温室効果ガス排出量 (2018年度比)	50.5%削減 ※1	42.5%削減
再生可能エネルギー	100% ※2	45.7%
グローバル 女性管理職比率	15% ※3	13.8%
女性または外国人の 本社役員比率	10% ※3	21%

※1：2030年度目標 ※2：2050年度目標 ※3：2025年度目標

“車載” “海外” での成長実現とさらなる成長に向けた基盤作り

- 当初想定していた有効需要が下振れしていることに加え、目標シェア未達の影響も大きい
- 「自動車」「パワーデバイス」の有効需要に限っては想定よりも上振れしており、注力すべき市場、製品の選択は正しかった
- 車載向け売上高は成長するも、産機は伸び悩んだ
- パワーデバイスを中心に海外売上比率が上がったものの、LSI中心に海外向けが伸び悩み、全社海外売上比率目標は未達
- SiCデバイスは足元のBEV市場の鈍化、競争環境の変化により、目標シェア未達
- 市況の変化への対応遅れ、過剰な設備投資・在庫保有により、収益性や資産効率性は悪化

ESGへの取組み

E	環境	■ 気候変動への対応は、計画に対し順調に進捗 ■ 水の回収・再利用率は2019年度比で4.6%向上
S	社会	■ 従業員エンゲージメントサーベイのグループ全体で導入完了 ■ 多様な働き方を支援する、人事施策・制度の充実
G	ガバナンス	■ 業務執行取締役に対し、中期経営計画連動の株式報酬制度を導入 ■ 2025年6月末では、社外取締役比率が過半数を超える予定

収益性改善のための構造改革

- FY25～27を構造改革期間と位置付けて市況変動に強い事業基盤の構築へ着手
- “ロームの強さへの原点回帰” を軸に**第2期中期経営計画**を立案中

売上成長以外での収益性改善策

				FY24比 利益改善寄与額(億円)	
				FY25	FY28
	生産拠点再編 IDMからの一部脱却	▶ 固定費削減	生産ライン・拠点の統廃合	10	>100
	設備投資圧縮	▶ 償却費削減	SiC投資計画の見直し 事業環境に則した会計処理へ変更	200	
	人員数適正化	▶ 労務費	25年3月希望退職実施	20	
	価格適正化	▶ 売上総利益増加	インフレコスト価格転嫁 不採算品の新商品置換	40	
合計				270	>360

マーケティング・開発の強化

産機・民生を強化し、バランスの良いポートフォリオへ

売上構成比率

- 民生・通信・C&S
- 産機
- 車載



あらゆる市場へ
果敢に挑戦

第1期中計期間

過去の成果

第1次中計期間は
車載に注力

- 民生 → 車載
- 高付加価値路線
- 安定的な市場の開拓

マーケティング強化

今後の取組み

産機・民生の
マーケティング強化

- 車 載 → 車載 + 産機・民生
- 製品軸 → アプリケーション軸
- 顧客視点でのソリューション提案

次世代のグローバル競争へ

将来目指す姿

あらゆる市場で
競争できる企業へ

- 民生で新技術をキャッチアップ
- 産機で高収益を実現
- 市場リスク分散 + 競争力UP

民生・通信・C&S市場で獲得した技術を自動車・産機市場で活用

技術革新を推進



民生・通信・C&S

- 技術革新が最も早い
- 車載・産機技術の基礎に
- 新市場の可能性をキャッチ
- 多様な顧客でリスク分散

技術を応用、高付加価値商品で利益創出



自動車

- 製品のライフサイクルが長い
- 高付加価値かつ高収益
- 安定性のある市場
- 大口顧客の比率が大きい



産機

- 少量生産による高い収益性
- 高い信頼性と耐久性が必要
- IDMで長期供給を保証
- 中小含めた幅広い顧客層

民生市場向け



AI・データサーバー

有効需要 : 1.4兆円
CAGR : +12%



スマート家電

有効需要 : 1.6兆円
CAGR : +3%

産機市場向け



FA/ロボティクス

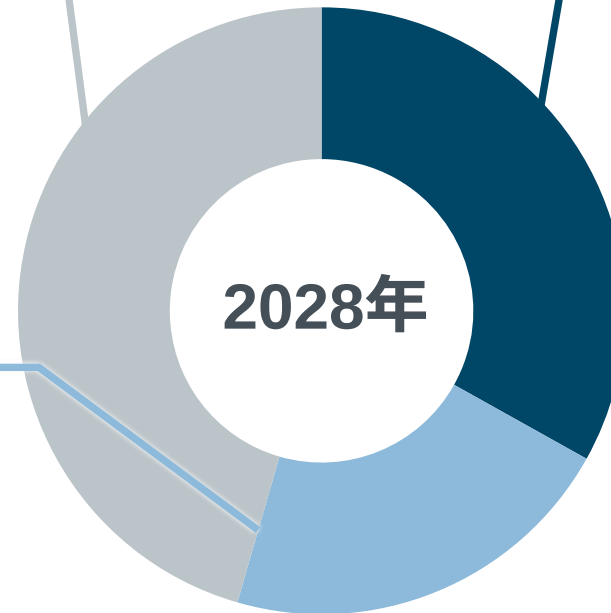
有効需要 : 1.3兆円
CAGR : +4%



再生可能エネルギー関連

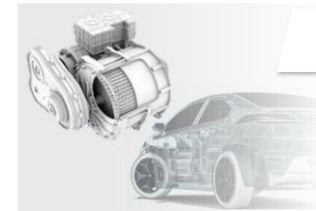
有効需要 : 1.8兆円
CAGR : +14%

ロームの有効需要
約**32兆円**
(CAGR : +6%)



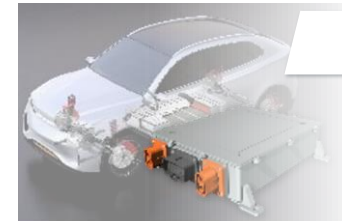
注力分野の有効需要
約**9兆円**
(CAGR : +10%)

車載市場向け



xEV インバータ

有効需要 : 1.6兆円
CAGR : +15%



xEV OBC+DC-DC

有効需要 : 0.8兆円
CAGR : +15%



ADAS/自動運転

有効需要 : 0.2兆円
CAGR : +18%



E/EアーキテクチャーゾーンECU

有効需要 : 0.3兆円
CAGR : +48%

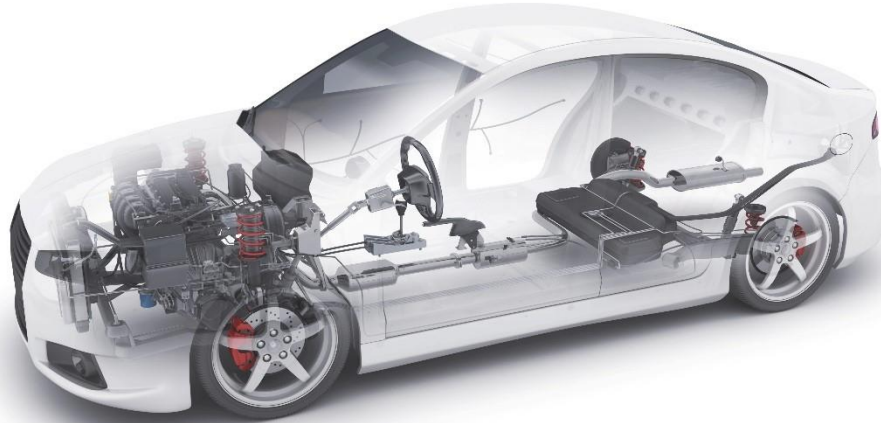
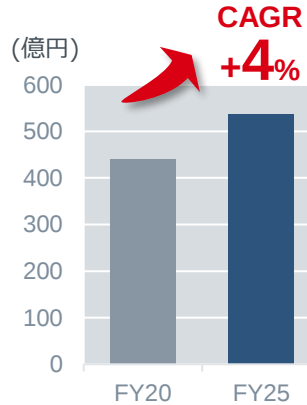
自動車市場向けのアプリケーションとその成果

SiCを含むパワー製品とアナログLSIの広範な製品ラインナップでE/Eアーキテクチャ実現をサポート

インフォテインメント



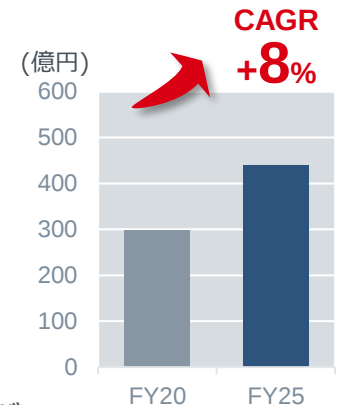
- 画像処理LSI
- LEDドライバ
- SerDes



ボディ



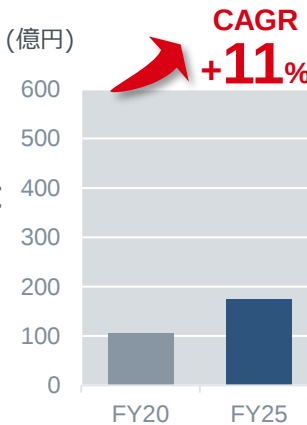
- LEDドライバ
- LDO
- IPD
- モータードライバ



ADAS・自動運転



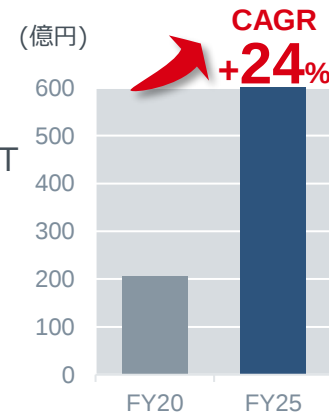
- SoC PMIC
- Camera PMIC
- Radar PMIC
- DC-DC
- LDO
- IPD
- SerDes
- TVS
- Laser Diode



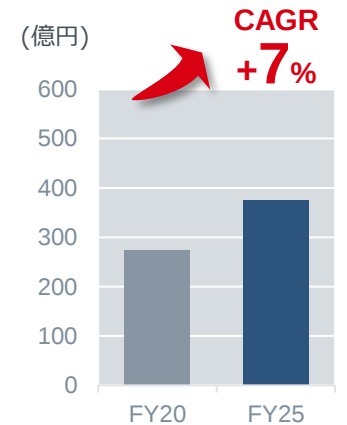
xEV関連 (インバーター・OBC etc)



- SiC/GaN/Si IGBT
- 絶縁ゲートドライバ
- 絶縁DC-DC
- 絶縁アンプ/ADC
- MCU PMIC
- IPD
- ショット抵抗



その他



伸長著しいAIデータサーバーのローム製品カバー率を増加させるべく、新製品企画と開発を加速中

拡販可能製品 有効需要

製品ラインナップ強化で
SAM※4倍

変圧設備

サーバラック

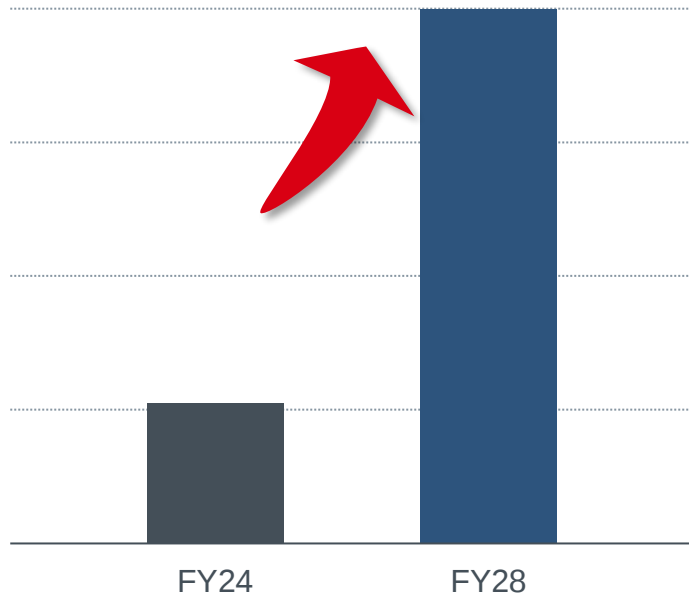


既存製品

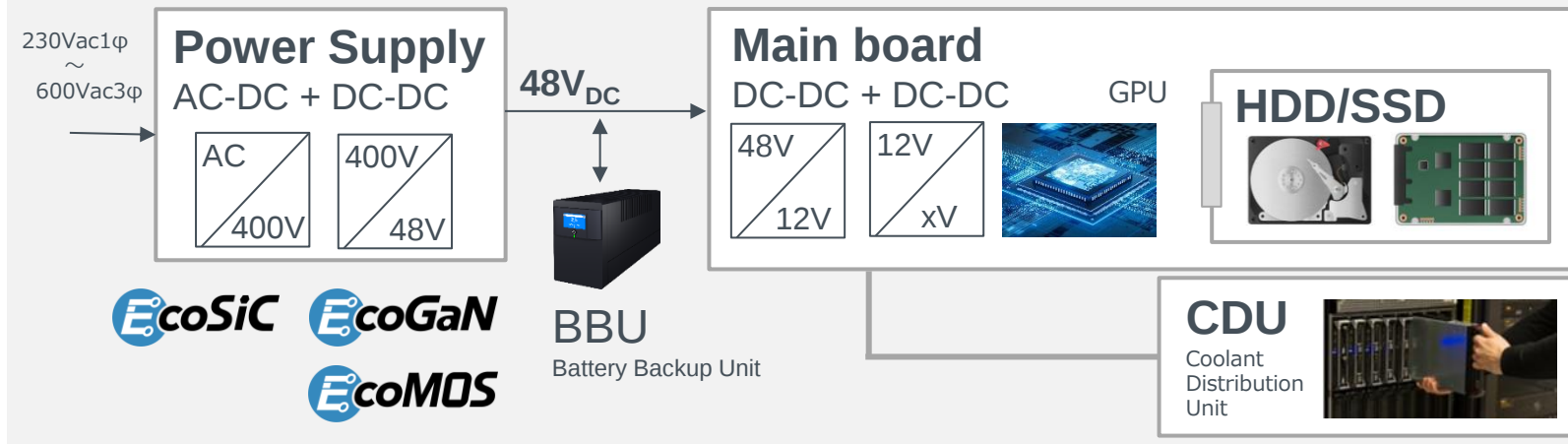
- SiC/GaN/Si IGBT
- 絶縁ゲートドライバ
- 冷却用FANドライバ
- SSD用PMIC
- HDD用複合モータドライバ

開発予定製品

- 大電流 LV MOS
- 絶縁DC-DC
- SoC/GPU用DC-DC
- eFuse

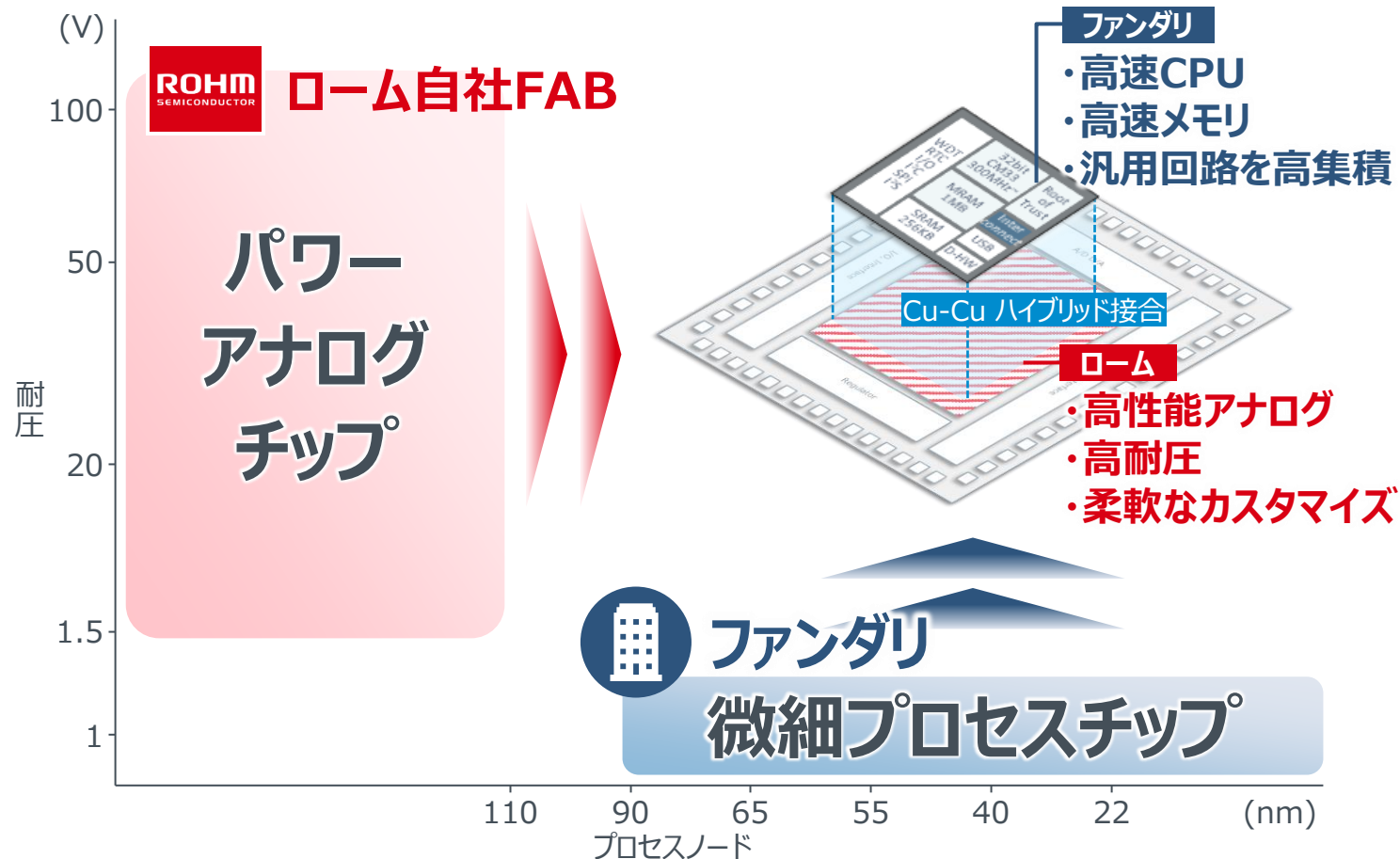


※Serviceable Available Market

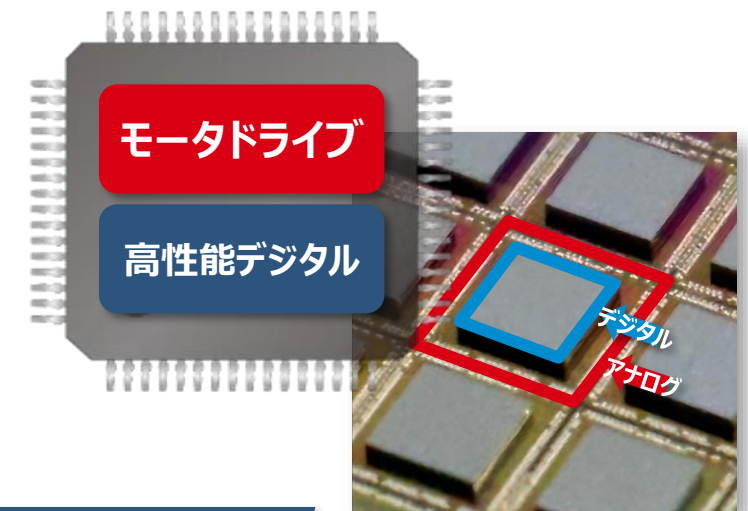


チップレット技術による、高付加価値ソリューションの創出

- **パワーアナログチップ°（ローム自社FAB）**と**微細プロセスチップ°（ファンドリ）**を**チップレット技術**を用いて貼り合わせることで製品化を実現。
- 従来、製品化ができなかった**微細プロセスチップ°**との融合による**新たな高付加価値ソリューション**を創出する。



LASCA™ 32bitチップレットマイコン

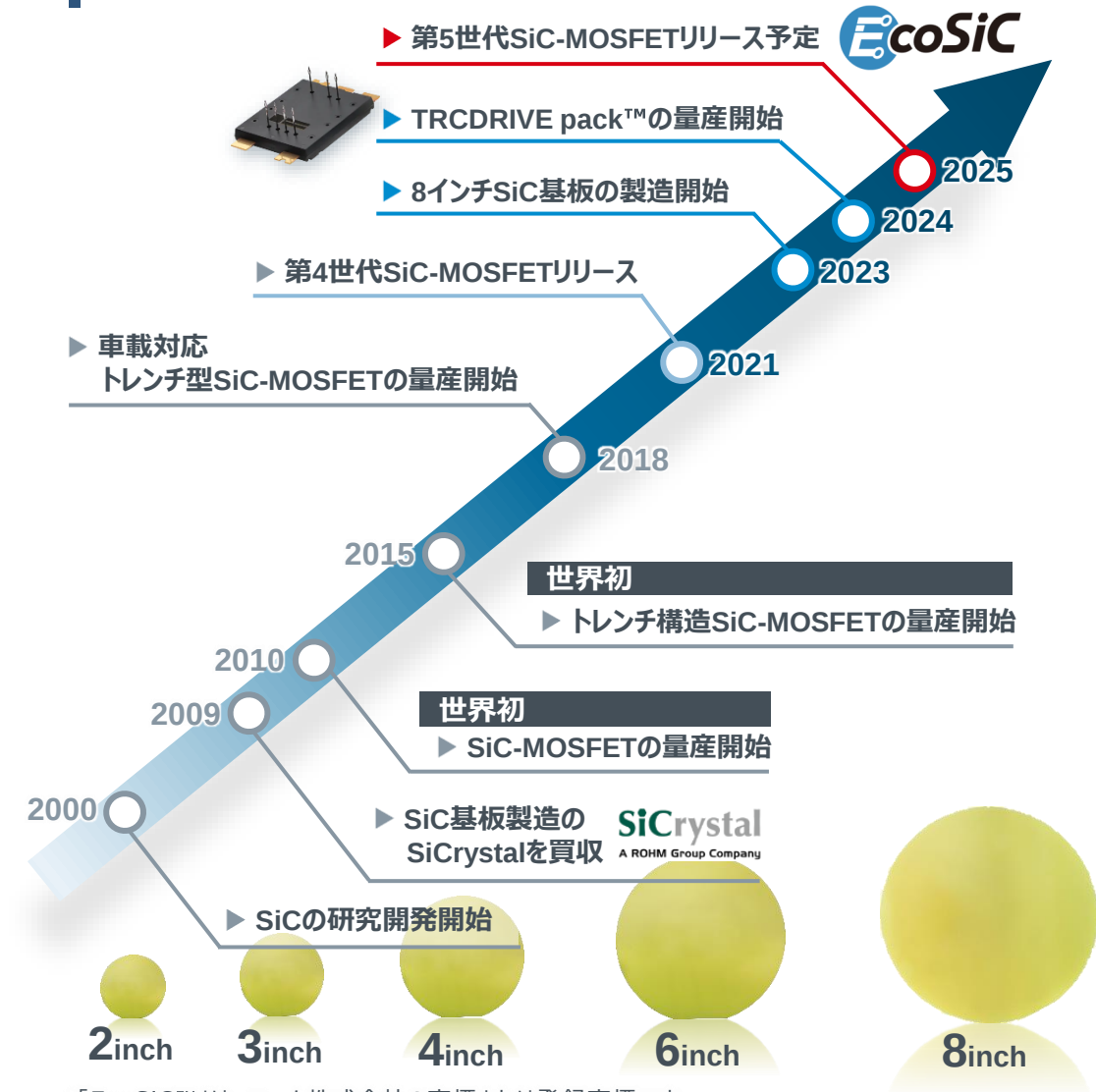


期待される用途

- ・エアコン室外機のモーター・電源制御用MCU
- ・センサー制御用MCU
- ・ウェアラブルデバイス用MCU

SiC事業の歴史・これまでの振り返り

SiC事業の歴史



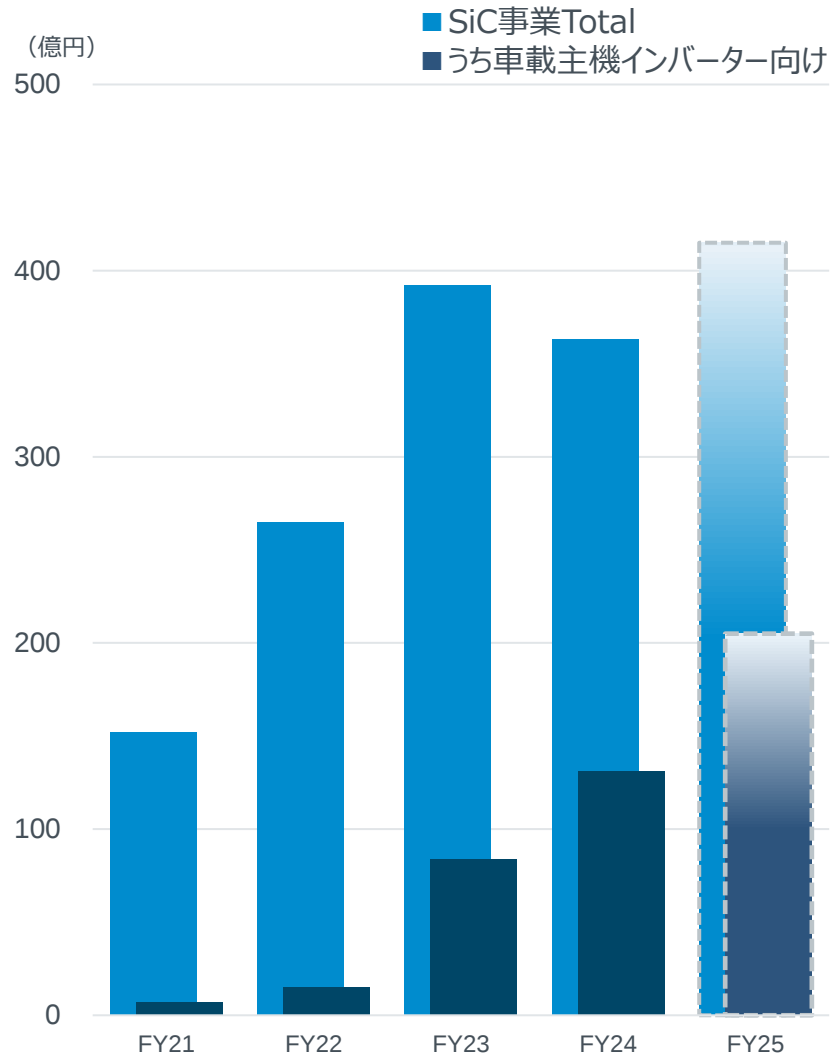
*「EcoSiC™」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

これまでの振り返り

項目	現状	内容
市場環境	△	脱炭素社会の実現に向けて市場は広がっているものの、足元でBEVの成長が鈍化
競合・シェア	△	- 投資競争の出遅れにより、急増当初にキャパを確保できず 勝ち馬に乗れなかったが、幅広く顧客へ展開 - 中国をはじめ、新規参入プレーヤーが多数出現
売上	×	- 売上成長の遅れにより、利益貢献時期は後ろ倒し - 後追いで投資を加速させたが、市況が悪化 - 新規投資の割合高く、競合に対して投資効率が悪い
技術	○	- SiC-MOSFETで業界トップクラスのオン抵抗を実現 8インチデバイスの開発スピードは業界トップクラス 競争力のあるモールドモジュールの量産を開始 - 中国製ウエハの台頭により、基板外販の成長性が低下

SiC事業の売上推移・今後の見通し

SiC事業の売上推移



今後の見通し

項目	現状	今後	内容
市場環境	△	↗ ○	一時的に成長率は鈍化しているものの、中長期的な市場拡大への期待に変化なし
競合・シェア	△	↗ ○	- 市場の供給過剰により、競争は激化の一途を辿る - SiC採用主機インバータにおけるBEV台数ベースのシェアは伸長しており、FY25で19% - 日系OEM/Tier1の立ち上がりによって、市場トップシェアを目指す - 欧州産基板に対する需要の高まりの可能性
売上	×	↗ ○	- FY27中の単月黒字化を目指す - 生産効率を上げつつ、需要に合わせて装置を導入 - パワーモジュールのデザインウイン拡大で、製品単価を上げる
技術	○	→ ○	5G以降の開発スピードアップで、トップ性能を維持 - 筑後工場でFY25中に8インチラインの構築完了 - 宮崎第二工場でFY26からデバイスの生産開始 - 基板内製化によるコスト優位性は今後も強み

大口径化による生産性とデバイスの先進性で業界をリード

FY25～27の累計投資額

前回発表
(2023年5月)

2,800億円

今回発表

1,500億円

アポロ筑後工場



2025年 8インチラインの構築完了

ラピス宮崎工場



ラピス宮崎第二工場



2025年 ウエハ関連の生産開始
2026年 デバイスの生産開始

第5世代・第6世代デバイスの開発は順調に進捗

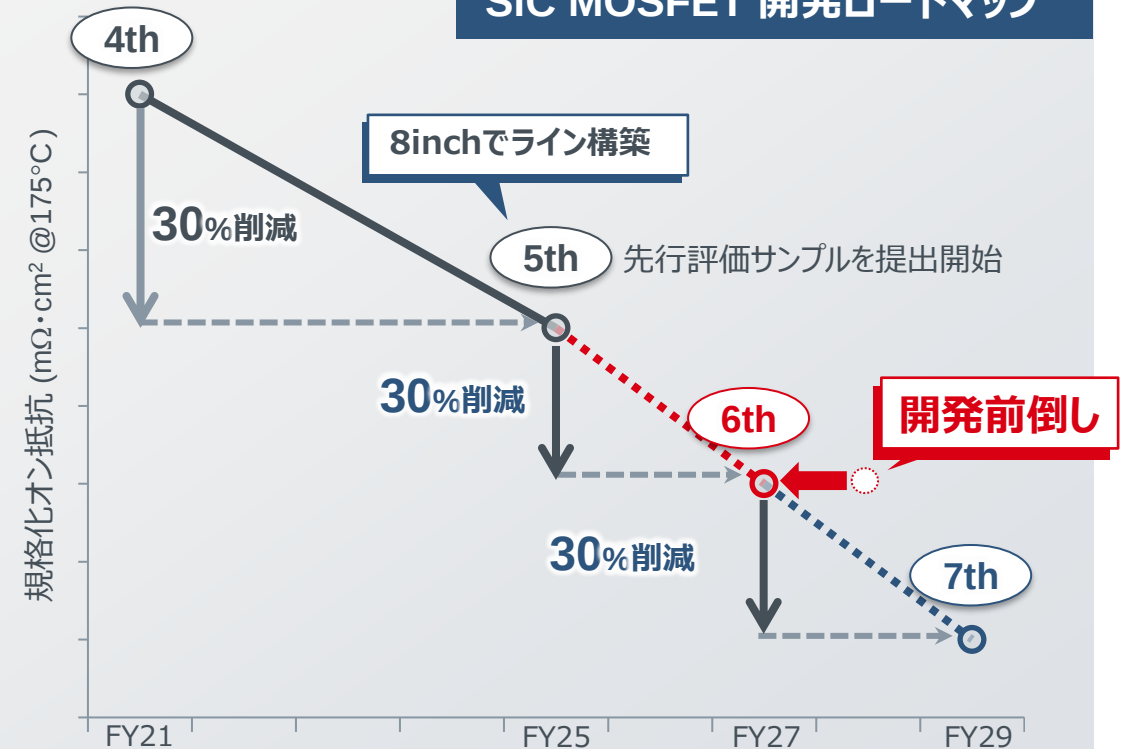
- 第6世代以降の開発を前倒し
- 各世代でオン抵抗を30%低減

顧客にとっての
メリット

性能アップ 同じチップ面積で、定格電流19%*アップ
コストダウン 同じ定格電流のとき、チップ面積を16%*削減

*ベストケース モジュール性能による

SiC MOSFET 開発ロードマップ

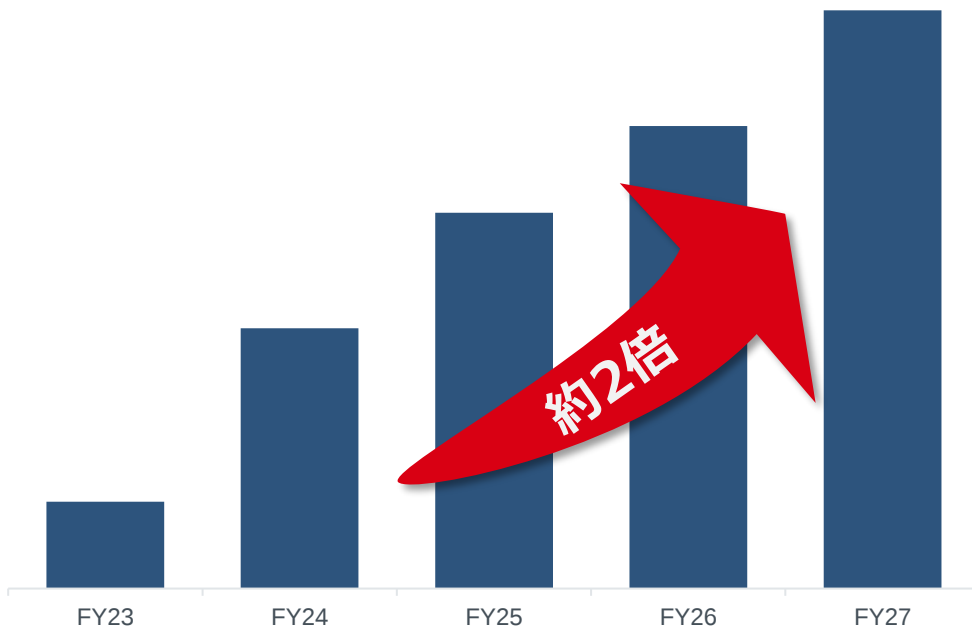


車載分野でのSiCデバイス採用実績

自動車OEMへのインバータ向けSiCデバイス採用実績

ローム調査に基づく

- OEM社数 27年カバー率 **50%***
- SiC採用インバータ 25年市場シェア **19%** (BEV台数ベース)
- 累積 採用OEM社数 **累計20社**



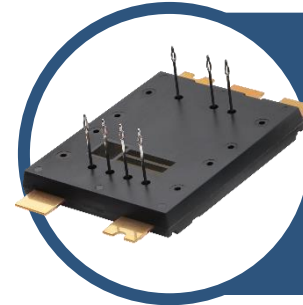
※2025年 BEV年間5万台以上販売予定のOEM対象

*TRCDRIVE pack™及びEcoSiC™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

モジュールビジネスによる高付加価値化



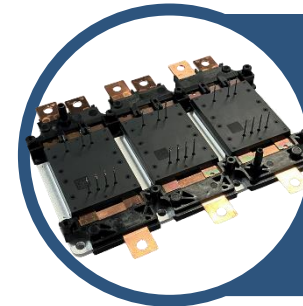
モジュール化による単価アップで、金額シェアアップへ繋げる。



車載インバータ向け TRCDRIVE pack™

電力密度が競合比1.5倍

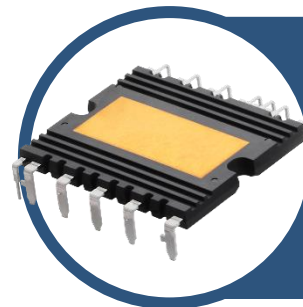
2024年量産出荷開始、デザインウィン4社獲得済み



POWER BOX (パワーモジュール+冷却器)

インバータ向けでデザインウィン (DW) 獲得

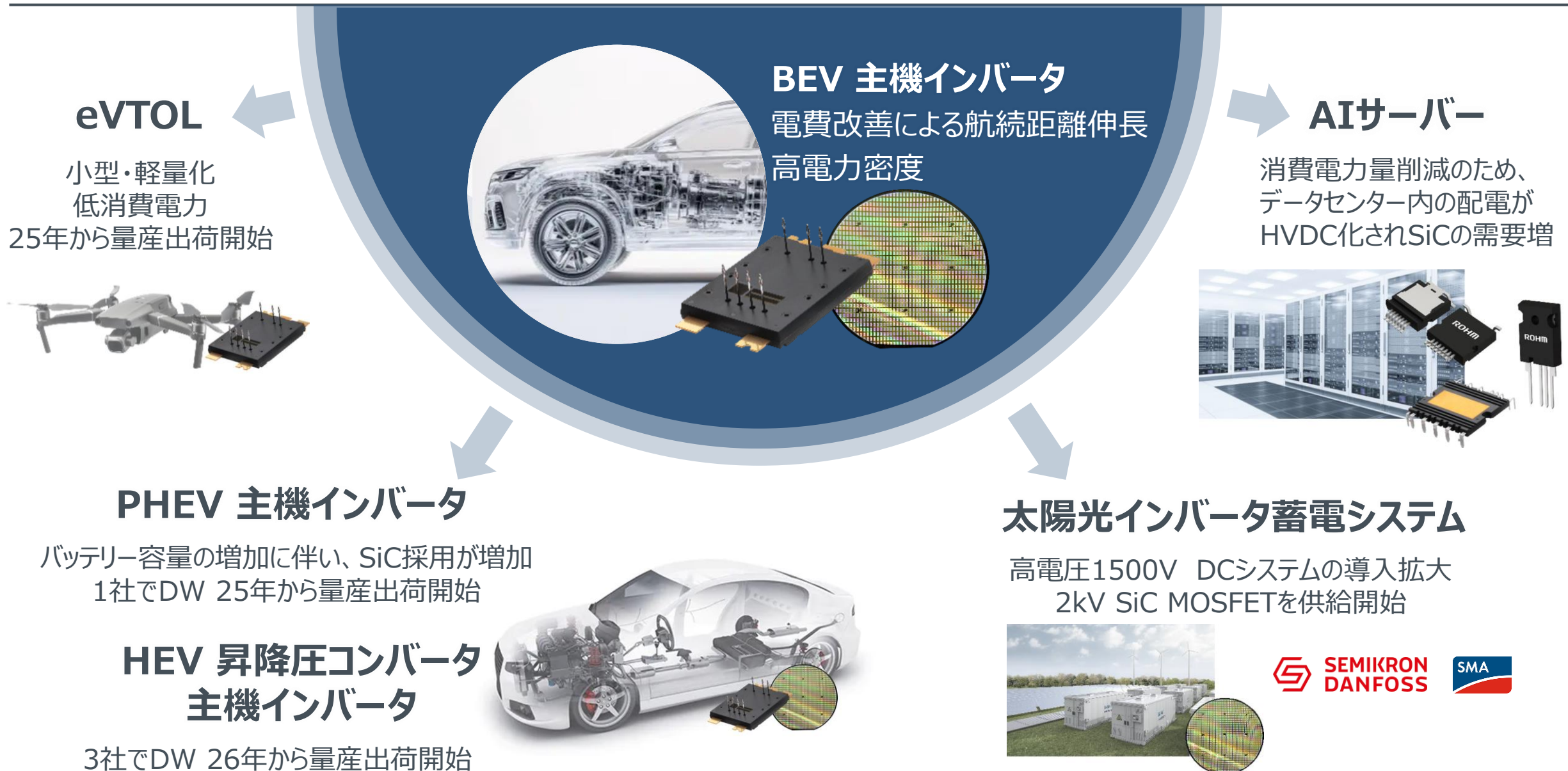
高付加価値化と顧客の実装課題解決に貢献



OBC、電動コンプレッサへのモールドモジュール採用拡大

2025年より新パッケージHSDIP20での量産を開始

BEV主機インバータ市場以外へのSiC採用の拡がり



＜ご注意事項＞

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2025年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

＜お問い合わせ先＞

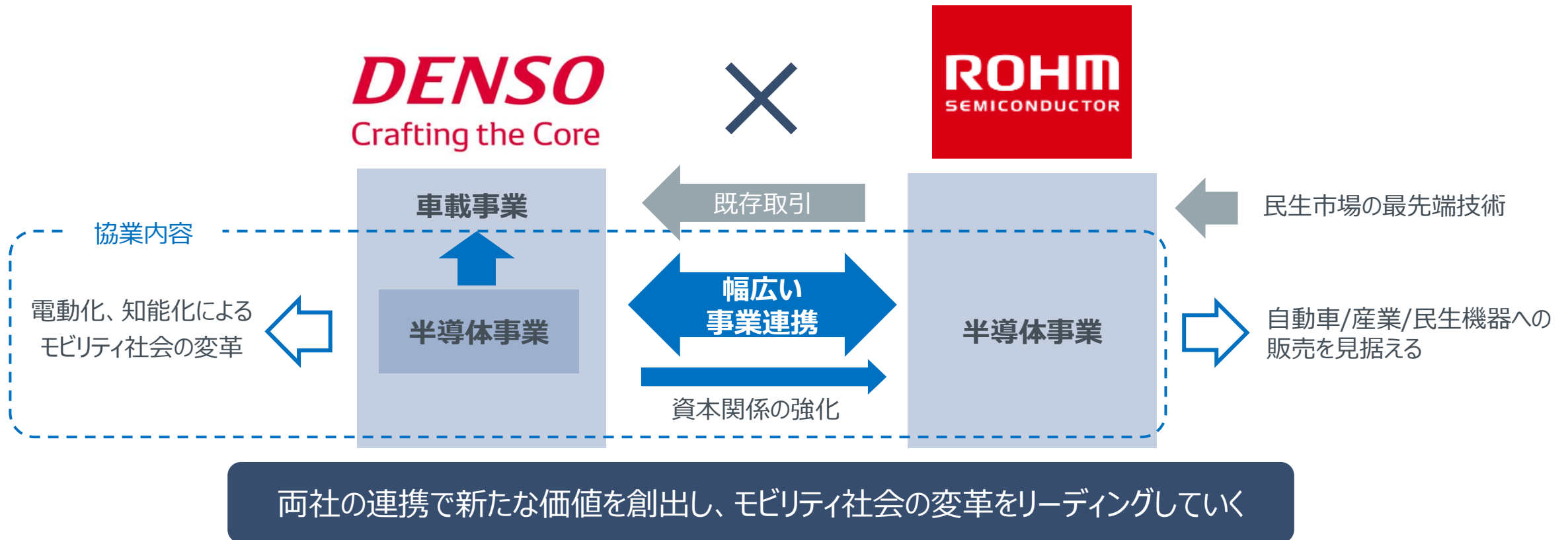
ローム株式会社 IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail : ir@rohm.co.jp



Electronics for the Future

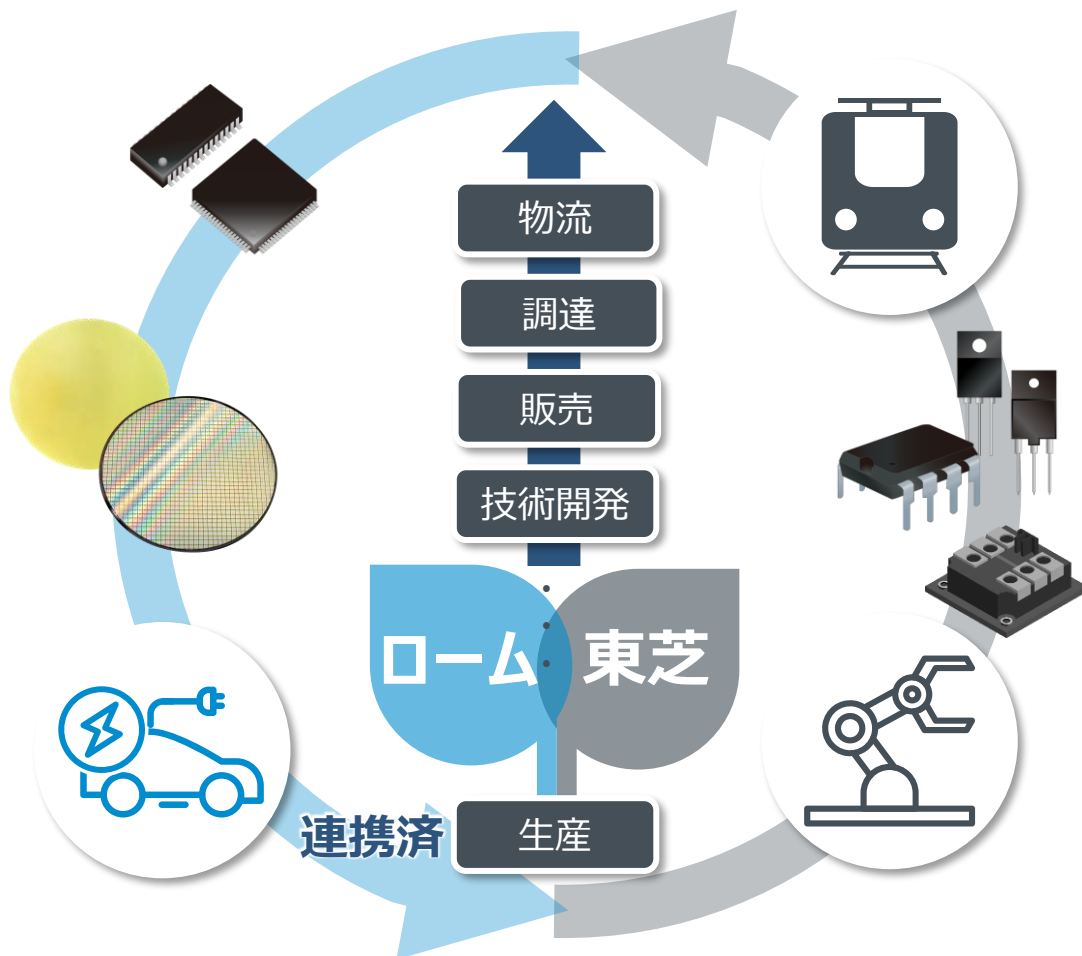
資本関係による強固なパートナーシップのもとで根幹となる車載コア技術を共有し、アナログICを中心としたデバイスの開発連携に合意。今後、親和性の高い分野でより幅広い連携も見据える。

戦略パートナーとして連携強化



東芝の半導体事業は、ロームとの親和性が高く、様々なシナジーを創出できる可能性があり、業務提携強化に向けた協議開始の提案を実施

ローム及び東芝双方の企業価値向上を目指す



提案の概要

東芝D&S半導体事業部を中心とした半導体事業に関して、技術開発、生産、販売、調達、物流など、あらゆる事業活動で連携を強化し、両社の企業価値向上を目指すもの。

パワー半導体におけるプレゼンスの向上

技術力の強化

供給力の拡大

2024年7月に東芝、及び日本産業パートナーズと業務提携強化に向けた協議を開始、現在、継続協議中。